

ams gibt Termine der Multi-Project-Wafer-Runs für die Produktion von Analog-ICs in 2015 bekannt

Einzigartige Kombination von Prototypen-Fertigung und Chip-Scale-Packaging bietet hohe Kosteneinsparungen und große Flexibilität für Foundry-Kunden

Unterpremstätten, Österreich (17. November 2014) Die Full-Service-Foundry-Abteilung der ams AG (SIX: AMS), einem führenden Anbieter von hochwertigen Sensor- und analogen IC-Lösungen, hat heute den aktualisierten Zeitplan für sein schnelles und kosteneffizientes IC-Prototyping-Service, bekannt als [Multi-Project Wafer \(MPW\) oder Shuttle Run](#), für das Jahr 2015 bekanntgegeben. Die Prototypenfertigung, bei dem mehrere Designs verschiedener Auftraggeber auf einem einzigen Wafer vereint werden, bietet erhebliche Preisvorteile für Foundry-Kunden, da die Kosten für Wafer und Masken zwischen den Teilnehmern des jeweiligen MPW Runs aufgeteilt werden.

Als eine zusätzliche Erweiterung der ams-Initiative „More than Silicon“ bietet das Unternehmen seinen Shuttle-Run-Kunden mit dem WLCSP-Verfahren (Wafer Level Chip Scale Packaging) jetzt Zugang zu modernster Assemblierungstechnik, die bei bestimmten MPW-Runs im Jahr 2015 eingesetzt werden wird. Diese einzigartige Kombination von Prototypenfertigung und Chip-Scale-Packaging bietet hohe Kosteneinsparungen und größtmögliche Flexibilität für Foundry-Kunden.

Das erstklassige MPW-Service von ams umfasst die komplette Palette an 0,18- μm - und 0,35- μm -Spezialprozessen. Um führende Halbleiterprozesstechnologien, -fertigung und -services im Analogbereich anbieten zu können, hat ams vier MPW-Runs im 0,18- μm -CMOS-Prozess (C18) sowie vier MPW-Runs in seiner fortschrittlichen 0,18- μm -Hochvolt-CMOS-Technologie (H18) mit 1,8-V-, 5-V-, 20-V- und 50-V-Transistoren vorgesehen. Für die 0,35- μm -Spezialprozesse, die auf den von TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) lizenzierten 0,35- μm -CMOS-Prozess aufsetzen, sind für 2015 insgesamt 14 Runs geplant. Die speziell auf Hochvolt-Designs in automobil- und industrietechnischen Anwendungen ausgelegten 0,35- μm -HV-CMOS-Prozesse sind für 20-V-, 50-V- und 120-V-Applikationen konzipiert. Der hochmoderne HV-CMOS-Prozess mit vollintegrierter EEPROM-Funktionalität sowie die 0,35- μm -SiGe-BiCMOS-Technologie (S35) sind vollständig kompatibel zum CMOS-Basis-Prozess und runden das MPW-Portfolio von ams ab.

Insgesamt bietet ams für 2015 beinahe 150 MPW-Starttermine an, was so nur durch die langjährige Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen wie [CMP](#), [Europractice](#), [Fraunhofer IIS](#) und [Mosis](#) möglich ist. Kunden aus Japan können unseren Service auch über unseren lokalen MPW-Programmpartner [Toppan Technical Design Center Co., Ltd \(TDC\)](#) wahrnehmen.

Der MPW-Terminplan für 2015 ist jetzt veröffentlicht worden und die genauen Starttermine für die jeweiligen Prozesse können auf <http://asic.ams.com/MPW> eingesehen werden.

Um den MPW-Service zu nutzen, übermitteln die Foundry-Kunden ihre vollständigen GDSII-Daten zu bestimmten Terminen und erhalten ungeprüfte, assemblierte Muster oder ungehäuste Chips. Die kurzen Lieferzeiten betragen normalerweise 8 Wochen für CMOS- und 12 Wochen für HV-CMOS-, SiGe-BiCMOS- und Embedded-Flash-Prozesse.

Alle Prozesstechnologien werden unterstützt vom bewährten und bekannten „hitkit“, dem branchenweiten Benchmark für Prozessdesignkits, das auf Entwicklungssoftware von Cadence, Mentor Graphics oder Keysight aufsetzt. Der hitkit ist voll ausgestattet mit 100% siliziumqualifizierten Standardzellen, Peripheriezellen und Analogzellen wie Komparatoren, Operationsverstärker und stromsparende A/D- und D/A-Wandler. Kundenspezifische Analog- und HF-Bauteile, Assura- und Calibre-Verifikationsregeln sowie präzise beschriebene Schaltungssimulationsmodelle ermöglichen einen unkomplizierten Einstieg in das Design von komplexen und leistungsfähigen Mixed-Signal-ICs. Über die standardmäßigen Prototyping-Services hinaus bietet ams modernste analoge IP-Blöcke, Speicherblöcke (RAM/ROM) und IC-Gehäuse aus Keramik oder Kunststoff.

Die Full Service Foundry Division von ams

Die ams-Abteilung für die IC-Auftragsfertigung mit Komplettservice hat sich erfolgreich auf dem Foundry-Markt für Analog-/Mixed-Signal-ICs positionieren können. Zu ihrem Prozesstechnologieportfolio gehören 0,18- μ m- und 0,35- μ m-Spezialtechnologien, die auf den Analog-, Mixed-Signal-, Hochspannungs- und HF-Prozessen von ams basieren. Mit der „More than Silicon“-Initiative bietet ams einen umfassendes Dienstleistungs- und Technikpaket, das weiter geht, als bei den branchentypischen Foundry-Services. Dazu gehören spitzentechnologische Erweiterungen wie 3D-IC Integration mittels Through-Silicon-Via-Technik, spezifische Farbbeschichtungen am Wafer, kundenspezifische Back-End-Prozesse, WLCSP und vieles mehr. Das Full-Service-Foundry-Paket wird abgerundet durch bestmöglichen Support in der Schaltungsentwurfsphase, durch leistungsfähige Tools und erfahrene Entwickler, durch hochwertige und qualifizierte Analog-IP-Blöcke sowie dem Angebot von Dienstleistungen für schlüsselfertige Lösungen.

Über ams

ams entwickelt und produziert High Performance Analog-ICs, die innovative Lösungen für die anspruchsvollsten Herausforderungen seiner Kunden bieten. Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio von ams umfasst Sensoren, Sensorschnittstellen, Power Management-ICs und Wireless-ICs für Kunden in den Märkten Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive.



ams mit Hauptsitz in Österreich, beschäftigt über 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden rund um die Welt. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com.

Kommunizieren Sie mit ams über die folgenden Social-Media-Kanäle:

Folgen Sie uns auf Twitter unter <https://twitter.com/amsAnalog> oder tauschen Sie sich mit uns aus auf http://www.linkedin.com/company/ams-ag?trk=hb_tab_compy_id_20853

Für weitere Informationen

Medien Kontakt

ams AG
Ulrike Anderwald
Marketing Communications
T: +43 (0) 3136 500 31200
press@ams.com
www.ams.com

Technischer Kontakt

ams AG
Andreas Wild
Marketing Manager, Full Service Foundry
T: +43 (0) 3136 500 31246
andreas.wild@ams.com
www.ams.com